

熱伝導性シリコーン
ギャップフィル材

TIA228GF

LI-81-23097 Issued Mar., '23
Silicones & Specialties,
Electronics Business Technology, TIM
Momentive Performance Materials Japan LLC

TIA228GF は、電気電子部品の放熱、絶縁封止を目的とした 2 成分付加型のシリコーンゲルです。
(A)成分と(B)成分を 1 : 1 の割合で混合し、室温下あるいは加熱することにより、柔らかいゴム・ゲル状に硬化します。硬化後は、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れ、広い温度範囲で安定した放熱性と電気絶縁性を示します。

特 長

- ◆ 熱伝導率が高く、放熱用途に適しています。
- ◆ 混合比が 1 : 1 (重量比) の使いやすい 2 成分形です。
- ◆ 流動性が小さく、形状保持性に優れています。
- ◆ 70℃以上の加熱により、短時間で硬化します。
- ◆ 硬化後は柔らかいゴム・ゲル状ですので、各種ストレスから部品を保護します。
- ◆ 付加反応タイプで金属に対する腐食性がありません。
- ◆ 難燃性に優れています。UL94V-0 相当品。

一般特性

硬化前 (23℃)		(A) 成分	(B) 成分
外 観		淡青色ペースト状	青色ペースト状
粘 度	Pa·s	230	230
混合比 (重量比)		1 : 1	
混合直後粘度	Pa·s	230	
作業可能時間	h.	1	
硬化条件 (加熱時)	℃/h.	70 / 0.5	
(常温下)	℃/h.	23 / 3	
硬化後 (硬化条件: 70℃, 0.5h.)			
外 観		青色ゴム状	
熱伝導率 ¹	W/m・K	2.8	
密 度	g/cm ³	2.9	
硬 さ (Shore 00)		80	
引張り強さ	MPa	0.5	
切断時伸び	%	60	
CTE	ppm/K	125	
体積抵抗率	MΩ・m	3.6 x 10 ⁴	
絶縁破壊の強さ	kV/mm	17	
低分子シロキサン (D ₄ -D ₁₀)	ppm	100	

1) ホットディスク法による

記載のデータは、弊社の試験方法による実測値・特性例であり、規格値ではありません。
ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本品の用途に関して、
いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。

TIA228GF

LI-81-23097

Issued Mar., '23

Silicones & Specialties,

Electronics Business Technology, TIM

Momentive Performance Materials Japan LLC

取扱い上の注意および保管について

- (1) 被着体の表面に油脂などが付着していると硬化が不十分となりますので、溶剤などで脱脂し、乾燥してください。
- (2) アミン、スズ、イオウなどを含むものと接触すると、硬化しないことがありますのでご注意ください。
- (3) 取扱い時には、保護眼鏡および必要に応じて、保護手袋を着用してください。
- (4) 局所排気装置を運転し、換気をよくして作業してください。
- (5) 直射日光を避け、湿気の少ない冷暗所に保管してください。
- (6) 子供の手の届かない所に保管してください。

消防法

非危険物。指定可燃物 合成樹脂類に該当。